

光大证券股份有限公司
关于

江苏华海诚科新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.

二〇二二年六月

上海证券交易所：

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”、“发行人”、“公司”）申请首次公开发行股票并在科创板上市，发行人本次公开发行股票总数不超过 2,018 万股，全部为公开发行新股。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）认为发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所科创板上市交易。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同。

保荐机构及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人王如意、岑圣锋已根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书真实、准确、完整。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明	2
目 录.....	3
一、发行人基本情况	4
二、发行人本次发行情况	15
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员	15
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明	16
五、保荐机构内部审核程序和内核意见	17
六、保荐机构承诺事项	18
七、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序	19
八、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明	19
九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排	25
十、保荐机构认为应当说明的其他事项	27
十一、保荐机构认关于本项目的推荐结论	27

一、发行人基本情况

(一) 发行人基本情况

中文名称	江苏华海诚科新材料股份有限公司
英文名称	Jiangsu HHCK Advanced Materials Co.,Ltd.
注册资本	6,051.65 万元人民币
实收资本	6,051.65 万元人民币
法定代表人	韩江龙
有限公司成立日期	2010 年 12 月 17 日
股份公司成立日期	2015 年 12 月 16 日
公司住所	江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号
邮政编码	222047
经营范围	电子、电工材料制造、销售；微电子材料研发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
联系电话	0518-81066978
传真号码	0518-82366016
互联网网址	www.hhck-em.com
电子信箱	ir@hhck-em.com
信息披露和投资者关系管理部门	公司董事会秘书办公室
信息披露和投资者关系管理部门负责人	董东峰
信息披露和投资者关系管理部门联系电话	0518-81066978

(二) 发行人主营业务概括

1、公司主营业务情况

公司是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。公司已发展成为我国规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商，在半导体封装材料领域构建了完整的研究生产体系并拥有完全自主知识产权。

作为研发驱动的半导体封装材料厂商，公司结合下游封装产业的技术发展趋势及客户定制化需求，针对性地开发与优化产品配方与生产工艺，掌握了高可靠

性技术、翘曲度控制技术、高导热技术、高性能胶黏剂底部填充技术等一系列核心技术，推动了经营业绩的快速提升。

依托公司的核心技术体系，公司形成了可覆盖传统封装领域与先进封装领域的全面产品布局。在传统封装领域，公司产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势，且应用于 SOT、SOP 领域的高性能类环氧塑封料产品性能已达到了外资厂商相当水平，并在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场份额持续增长；在先进封装领域，公司已成功研发了应用于 QFN、BGA、FC、FOWLP、SiP 等封装形式的封装材料，且相关产品已陆续通过客户的考核验证，充分体现了公司技术水平的先进性。

随着技术研发的突破、产品体系的完善及市场渠道的开拓，公司的技术水平、产品质量与品牌获得了下游知名客户的认可，逐步发展成为内资领先环氧塑封料厂商之一。

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
环氧塑封料	32,943.56	95.08%	22,826.08	92.21%	15,474.12	89.98%
电子胶黏剂	1,704.11	4.92%	1,927.58	7.79%	1,722.37	10.02%
合计	34,647.67	100.00%	24,753.66	100.00%	17,196.49	100.00%

2、公司主要经营模式

公司深耕于半导体封装材料领域，始终以技术与产品创新作为持续发展的核心驱动力，致力于为客户持续提供具有竞争力的半导体封装材料。

在研发模式方面，公司以下游封装技术发展趋势与客户定制化需求为导向，持续开展半导体封装材料配方及生产工艺的开发与优化。在研发过程中，公司需要筛选出适合的原材料，确定各种物料的添加比例、添加顺序、混炼温度、混炼时间、混炼速度等生产工艺参数，从而在各理化性能指标的相互作用之间达到平衡，实现良好的综合性能；在生产模式方面，公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式，可根据客户提出的各类要求及时做出响应，并根据市场需求对产品种类和产量进行快速调整；在销售模式方面，公司主要采取

直销模式，有利于客户更高效地获得产品，也有助于深入了解客户的需求并持续提供具有竞争力的产品。

报告期内，公司现有经营模式取得了良好的效果，产品与技术布局持续完善，业务规模快速增长，公司经营模式未发生重大变化，在可预见的未来也不会发生重大变化。

3、公司市场竞争地位

凭借丰富且具有前瞻性的技术积累、扎实且具有创新性的研发实力、稳定可靠的产品质量和优质的客户服务，报告期内，公司业务规模快速增长，目前已发展成为一家技术先进、产品系列齐全、产销量规模较大的内资环氧塑封料企业，并已进入到众多知名客户的供应商体系，在技术水平、产品质量、交货期、服务响应速度等方面赢得了客户的高度认可。

截至本上市保荐书签署日，公司已与华天科技、通富微电、长电科技、富满微、扬杰科技、气派科技、银河微电等下游知名厂商建立了长期良好的合作关系，相关产品已在上述部分厂商实现对外资厂商产品的替代，并积极配合业内主要厂商开展应用于先进封装的“卡脖子”材料的技术开发与产业化。

在我国半导体产业景气度不断提升、整体国产化进程持续推进的背景下，公司作为内资环氧塑封料代表厂商之一，将凭借自身的研发、产品、服务、口碑等优势进一步提升市场份额。

（三）发行人核心技术和研发水平

1、发行人核心技术的先进性

由于半导体封装材料对半导体器件的性能有显著影响，不同客户对于公司产品的各项性能指标都有各自独特需求，因此性能指标均需要以满足客户定制化需求为导向，通过客户验证或者实现对进口或外资产品的替代是公司产品性能指标与公司技术水平最重要的体现。

报告期内，公司产品在传统封装与先进封装领域均取得了较大的突破，充分体现了公司技术的先进性，具体如下：

（1）公司应用于传统封装的产品存在优势地位，应用于 SOT、SOP 等领域

的高性能类产品已在部分知名封装厂商逐步实现了对外资厂商的替代

在传统封装领域，公司已掌握了历代传统封装技术用环氧塑封料所需的主要技术，可有效解决客户的需求难点，品牌知名度与市场份额呈现持续提升的趋势。凭借自主研发的连续成模性技术、低应力技术等核心技术，公司先后推出了 EMG-350、EMG-480 以及 EMG-600 等多系列具有市场优势的产品，被广泛运用于消费电子、光伏组件、汽车电子等领域，形成了品质稳定、性能优良、性价比高等优势。

公司的传统封装用环氧塑封料已在国内主要的封装厂商长期且稳定地使用，且应用于 SOT、SOP 领域的高性能类环氧塑封料产品性能已达到了外资厂商相当水平，并在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场份额持续增长，技术水平得到了客户和市场的一致认可，销售规模在报告期呈现快速增长趋势。

（2）公司应用于先进封装的产品已在客户验证中取得一系列突破

随着传统封装逐步迈向先进封装，封装技术的持续演进对环氧塑封料提出了更多、更严苛的性能要求。因此，在先进封装用产品的配方开发中，塑封料厂商需要在各性能指标间进行更为复杂的平衡，产品开发难度进一步加大。在先进封装领域的布局情况也成了内资塑封料厂商技术实力的重要体现之一。

经过数年研发积累与实践，公司以先进封装的技术特征与客户日益提升的性能需求为导向，在应用于先进封装材料领域实现了具有创新性与前瞻性的技术与产品布局，相关产品已逐步通过客户严苛的考核验证，体现了公司技术先进性。具体情况如下表所示：

应用领域	代表型号	产品进度
QFN	EMG-700-NCJ	应用于 QFN 的产品已通过通富微电、长电科技等厂商的认证，获得了“可靠性等级 MSL3，翘曲良好，可替代进口材料”的结论，已实现小批量生产与销售
BGA	EMG-700- BH	正在长电科技、华天科技等厂商的考核验证中
FC	656 系列（FC 底填胶）	已通过星科金朋的考核验证
SiP	EMG-900-HM/HM-L	EMG-900-HM 已通过客户考核验证，获得了“无分层、无气孔、无开裂，无模流填充，MSL3 测试通过，无分层导致不良”的结论
FOWLP/FOPLP	68 系列（液态塑封料 LMC）	已在通富微电、华进半导体等客户开展了工艺性能验证
	EMG-900-ACF（GMC）	GMC 相关产品已通过佛智芯的验证，可提供适用于压缩

	颗粒状塑封料)	成型工艺的颗粒状产品
--	---------	------------

综上，公司的技术布局与未来下游封装技术发展趋势相匹配，具有前瞻性与先进性，为公司业绩保持可持续增长奠定了良好的技术基础。

2、研发技术产业化情况

公司深耕于半导体封装材料的研发创新，核心技术以配方技术与生产工艺技术作为体系基础，可广泛应用于传统封装与先进封装领域，技术储备丰富且具有前沿性，可为公司解决历代下游主流封装技术的需求难点提供有力的技术支撑。截至本上市保荐书签署日，公司已取得了专利共 94 项，其中发明专利 24 项。

公司在加大核心技术开发的同时，注重在半导体封装材料领域的研发成果的深度运用，注重将相关技术产业化落地。依托公司具有市场竞争优势的核心技术体系，公司专注于向客户提供更有竞争力的环氧塑封料与电子胶黏剂产品，构建了可应用于传统封装（包括 DIP、TO、SOT、SOP 等）与先进封装（QFN/BGA、SiP、FC、FOWLP/FOPLP 等）的全面产品体系，可满足下游客户日益提升的性能需求。

凭借扎实的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司已与长电科技、通富微电、华天科技、气派科技、银河微电、扬杰科技等业内领先及主要企业建立了稳固的合作伙伴关系，业务规模持续扩大，有序实现了研发技术的产业化，推动了经营业绩的快速提升。报告期内，公司营业收入年均复合增长率达到了 42.01%。

3、研发投入情况

公司以技术创新驱动业务发展，每年需投入大量资金进行研发工作。报告期内，公司的研发投入构成及占比情况如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年	合计
研发费用	1,883.63	1,555.34	1,205.86	4,644.84
营业收入	34,720.03	24,765.40	17,216.98	76,702.40
研发费用占比	5.43%	6.28%	7.00%	6.06%

（四）主要经营和财务数据及指标

财务指标	2021.12.31/ 2021 年	2020.12.31/ 2020 年	2019.12.31/ 2019 年
流动比率（倍）	2.67	1.14	1.13
速动比率（倍）	2.18	0.97	0.92
资产负债率（母公司）	30.88%	71.69%	70.80%
资产负债率（合并）	30.77%	65.71%	65.58%
应收账款周转率（次）	3.16	2.58	2.10
存货周转率（次）	4.70	5.03	3.79
息税折旧摊销前利润（万元）	6,745.85	4,302.76	1,552.87
归属于母公司股东的净利润（万元）	4,760.08	2,710.50	408.69
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	4,088.49	2,067.61	-42.05
研发投入占营业收入的比例	5.43%	6.28%	7.00%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.03	-0.15	0.25
每股净现金流量（元/股）	1.38	-0.01	-0.34
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	5.68	2.60	1.97

（五）发行人存在的主要风险**1、技术风险****（1）先进封装用环氧塑封料产业化风险**

环氧塑封料及芯片级电子胶黏剂是半导体封装的关键材料，产品性能直接影响半导体器件的质量。随着封装形式不断演进，先进封装占据的市场份额逐步扩大，先进封装所呈现出高密度、多功能、复杂度高等特点对半导体封装材料提出了更高的性能要求，下游封装厂商在选择材料供应商时也需要履行更为严苛的考核验证。

在高端半导体封装材料由外资厂商垄断的背景下，公司已成功研发可应用于 BGA、SiP 以及 FOWLP/FOPLP 等先进封装领域的高端封装材料，目前仍处于通过或正在通过客户考核验证阶段，均未实现大批量生产，预计得到下游广泛认可并实现产业化仍需要一段时间。未来，若公司应用于先进封装的产品的产业化不及预期，将对公司长远发展产生不利影响。

（2）研发不及时或进度未达预期风险

公司紧跟下游封装技术的演进趋势，构建了可应用于传统封装与先进封装领域的技术与产品布局。然而，目前公司整体的技术水平与外资主要厂商仍存在差距，尤其在高端产品领域的验证与应用的机会相对较少。因此，如果公司不能紧跟半导体封装材料的技术发展趋势，或未能充分关注客户的定制化需求，公司将可能由于技术研发不及时或研发进度未达预期，导致无法及时推出新产品而影响收入增长，从而对发行人的经营业绩产生不利影响。

（3）核心技术人员流失与技术泄密风险

半导体封装材料行业属于技术密集性行业，研发团队的稳定性、配方技术与生产工艺技术的创新性是公司保持竞争优势的关键基础，也是公司能持续取得技术突破的核心因素之一。如果未来核心技术人员流失，或在生产经营过程中相关技术、配方等保密信息泄露，可能存在核心技术泄密或被外界盗用的风险，从而对公司保持核心竞争力造成不利影响。

2、经营风险

（1）市场竞争风险

半导体封装材料的市场集中度相对较高，公司主要产品环氧塑封料与外资主要厂商存在直接竞争关系，公司在研发能力、技术储备、销售渠道和市场声誉等方面与外资厂商相比仍有差距。

在传统封装领域，应用于 TO、DIP 等封装形式的基础类环氧塑封料市场已由发行人为代表的内资厂商主导；在应用于 SOT、SOP 等封装形式的高性能类环氧塑封料领域，公司产品质量与外资厂商相当，但外资厂商凭借先发优势、品牌及技术优势，在该领域仍占据主导地位。在先进封装领域，公司应用于 QFN 等封装形式的产品已实现小批量生产和销售，BGA、SiP 及 FOWLP/FOPLP 等封装形式的产品尚未实现产业化，外资厂商在先进封装领域处于市场垄断地位。

因此，发行人预计在未来较长时间内将继续追赶外资先进企业。如果竞争对手开发出更具有市场竞争力的产品、提供更好的价格或服务，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。

此外，随着中国大陆半导体产业链的日益完善、终端应用市场的不断增长

以及国产替代进程的加快，市场将可能出现新的半导体封装材料企业，公司将面临国际先进企业和中国新进入者的双重竞争。如果公司无法有效应对上述竞争，公司的业务收入、经营成果和财务状况都将受到不利影响。

（2）客户认证风险

公司生产的环氧塑封料与芯片级电子胶黏剂需要经过客户的严格认证，方可实现销售。在客户考核验证公司产品期间，公司需要花费研发、销售、管理等相关支出，且该等支出并不能确保公司产品通过考核验证。若公司产品不能如期获得新客户的认证，或者公司新产品不能如期获得原有客户的认证，公司在前期的相关投入可能无法收回，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

（3）宏观经济及行业波动的风险

公司所处的半导体封装材料是半导体产业链的关键支撑行业，其需求受下游半导体封装厂商资本性支出及终端消费市场需求波动的影响较大。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致消费电子、网络通信、计算机、汽车电子、物联网等终端市场需求下降，在行业景气度下降过程中，封装材料厂商亦将面临产能过剩的局面，从而对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

同时，在行业景气度提升的周期，公司必须提高产能产量以满足预期的客户需求，这要求公司及供应商增加库存、扩大生产能力。如果公司不能及时应对客户需求的快速增长，或者对需求增长的期间、持续时间或幅度判断错误，可能会导致公司失去潜在客户或者库存积压，进而会对公司的业务、经营成果、财务状况或现金流量产生不利影响。

（4）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营影响

近年来，新冠肺炎疫情相继在全球各地爆发，对全球产业链造成了不利影响。目前，国内疫情仍存在多点散发的特点，疫情防控形势较为严峻，隔离等疫情防控措施将可能对公司原材料供应、生产经营及下游需求存在不利影响。海外基本实现疫情防控常态化，但不排除未来因新冠病毒变异等原因导致防控进一步升级。总体来看，新冠肺炎疫情的影响短期内难以消除，未来一段时间仍将影响全球各国的宏观经济形势。若未来疫情进一步蔓延，造成产业链失衡加剧，将对公司的经营活动和业绩造成不利影响。

3、财务风险

(1) 应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款的账面余额分别为 9,107.52 万元、10,104.00 万元和 11,870.43 万元，占营业收入的比例分别为 52.90%、40.80%和 34.19%。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加，较高的应收账款余额将影响公司的资金周转效率。如果公司采取的收款措施不力或未来下游行业客户付款能力发生变化、预算收紧、审批流程延长，则公司应收账款余额将不断增加，可能导致公司存在营运资金紧张、应收账款发生坏账的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

(2) 关联交易增加的风险

报告期内，公司向关联方采购的金额分别为 1,091.36 万元、1,549.36 万元、2,195.88 万元，占采购总额的比例分别为 10.23%、10.37%、9.28%；向关联方销售的金额分别为 3,249.39 万元、4,824.36 万元、4,160.47 万元，占营业收入的比例分别为 18.87%、19.48%、11.98%。公司的关联方客户主要是封装行业的上市公司，如华天科技及银河微电。若未来公司与关联方持续加大业务合作规模，则公司向关联方采购、关联方销售的交易金额存在进一步增加的可能性。

(3) 毛利率波动的风险

报告期各期内，公司主营业务毛利率分别为 29.95%、30.82%和 29.10%。公司产品毛利率主要受产品结构、下游需求、产品售价、原材料价格、公司技术水平以及商务谈判等多种因素影响，若上述因素发生变化，可能导致公司毛利率波动，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

(4) 税收优惠政策变化的风险

报告期内，发行人享受高新技术企业所得税的税收优惠；子公司连云港华海诚科按照国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》、《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》等相关政策享受小型微利企业的所得税优惠。报告期内，公司税收优惠占利润总额的比例分别为 6.85%、9.74%和 7.84%。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得高新

技术企业资格或不满足其他相关税收优惠条件等，将对公司的经营业绩造成一定不利影响。

（5）汇率波动的风险

公司在进口部分原材料时主要使用美元、日元等外币进行结算，人民币对外币的汇率波动受国内外经济、政治等多重因素共同影响。报告期内，公司汇兑损益分别为-30.99万元、50.56万元、54.89万元，汇率波动可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定不利影响。

（6）整体变更存在累计未弥补亏损的风险

发行人以2015年7月31日为改制基准日，整体变更为股份有限公司，于改制基准日，华海诚科有限累计未分配利润为-2,495.52万元，存在未弥补亏损。发行人完成整体变更后，业务规模持续增长，业绩水平稳步提升；截至2021年12月31日，华海诚科母公司未分配利润为7,642.99万元。

4、内控及法律风险

（1）质量控制风险

环氧塑封料是半导体产业的基础材料，环氧塑封料的性能直接影响到终端产品的可靠性。如果公司产品质量管理无法跟上下游封装企业的需求，或因生产过程中相关工艺环节控制不当，可能导致对其产品质量及行业声誉造成一定的影响，从而对公司持续经营产生不利影响。

（2）知识产权纠纷风险

半导体塑料封装材料行业属于技术密集型行业，涉及的知识产权数量众多。发行人一直高度重视自主知识产权的研发及保护工作，通过自主研发在配方工艺及生产工艺等方面先后形成了多项核心技术，部分核心技术已通过申请专利进行保护，但是仍然无法避免竞争对手或其他利益相关方通过模仿窃取公司的知识产权或者对公司进行恶意诉讼，进而影响公司正常的生产经营开展。

（3）内控制度执行不严风险

内部控制制度是保证财务和业务正常开展的重要因素。若公司有关内部控制制度不能有效地贯彻和落实，将直接影响公司经营管理目标的实现、公司财

产的安全和经营业绩的稳定性。

(4) 规模扩张导致的管理风险

如果公司本次发行成功，公司的资产规模与经营规模将实现较大的提升，使得公司的组织结构和经营管理更加复杂，对公司的管理水平将提出更高的要求。虽然在过去的经营实践中，公司已积累了不少管理经验，但是面对资本市场的考验和更高的管理要求，公司仍可能存在一定的管理风险。

(5) 部分房屋建筑物权属瑕疵风险

发行人存在部分建筑物未办理产权证书，该部分建筑面积合计 1,362.57 平方米，占公司全部建筑面积的 5.87%，账面价值合计 413.83 万元，占公司全部建筑物账面价值的 7.86%，主要为地源热泵房、地下消防泵房、仓库及门卫等临时建筑。虽然上述房产非发行人主要生产经营场所，但可能面临因产权手续不完善而拆除的风险，进而对公司的生产经营产生不利影响。

5、募投项目的风险

(1) 募投项目实际效果不及预期的风险

本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析系基于当前较为良好的市场环境及公司充足的技术储备，在市场需求、技术发展、市场价格、产能供应等方面未发生重大不利变化的假设前提下作出的。若在项目实施过程中，外部环境出现重大变化，可能导致募投项目不能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离。如果研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者未来市场的发展方向偏离公司的预期，致使研发出的产品未能得到市场认可，则募集资金投资项目可能面临研发失败或市场化推广失败的风险，前期的研发投入将难以收回，募集资金投资项目预计效益难以实现，对公司业绩产生不利影响。

(2) 募投项目实施后新增折旧和摊销导致利润下滑的风险

募投项目建成后，公司固定资产和无形资产将有一定程度的增加。在现有会计政策不变的情况下，公司每年固定资产折旧及无形资产摊销也将相应增加。如果市场环境等因素发生不利变化，募投项目投产后公司的盈利水平整体不及预期，新增折旧及摊销将对公司的经营业绩产生不利影响。

6、发行失败风险

公司股票拟在上海证券交易所科创板上市，除公司经营和财务状况之外，发行结果还将受到国内外宏观经济形势、资本市场走势和各类重大突发事件等多方面因素的影响，存在未能达到预计市值上市条件的风险，以及因投资者认购不足而导致的发行失败风险。

二、发行人本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数及占发行后总股本的比例	本次拟公开发行的股票不超过 2,018 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情况
每股发行价格	【】元
发行方式	采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会、上海证券交易所等监管部门认可的其他方式
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构子公司光大富尊投资有限公司将参与本次发行战略配售，具体按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的跟投规则实施。
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所人民币普通股（A股）证券账户上开通科创板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外），中国证监会或上海证券交易所另有规定的，按照其规定处理
承销方式	余额包销
拟上市证券交易所	上海证券交易所

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员

光大证券指定王如意、岑圣锋为华海诚科首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。谈钟灵为项目协办人，申正、吴健为项目组成员。

（一）负责本次证券发行的保荐代表人及其执业情况

王如意先生，现任光大证券股份有限公司新兴产业融资部资深董事，保荐代表人，非执业注册会计师，管理学硕士。2011年起从事投资银行业务，作为保荐代表人或项目组负责人曾参与的项目包括：阿科力（603722）IPO项目、佰奥智能（300836）IPO项目、南亚新材（688519）IPO项目、航亚科技（688510）IPO项目、力芯微（688601）IPO项目及多个新三板挂牌项目等，具有丰富的投

资银行从业经验。

岑圣锋先生，现任光大证券股份有限公司新兴产业融资部高级董事，保荐代表人，非执业注册会计师。2010年起从事投资银行业务，主持、参与新农股份、泰坦股份、久泰精密等公司首次公开发行改制、辅导、申报等工作；主持、参与新开普非公开发行项目、新能泰山重大资产重组项目、银轮股份、康强电子等再融资项目，具有丰富的投资银行从业经验。

（二）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人

项目协办人：谈钟灵女士，现任光大证券股份有限公司新兴产业融资部高级经理，硕士研究生学历，法律职业资格。2015年起从事投资银行业，作为项目组主要成员曾负责或参与的项目包括：阿科力（603722）IPO项目、佰奥智能（300836）IPO项目、怡达股份（300721）再融资项目及多个新三板项目等，具有较丰富的投资银行从业经验。

2、项目组其他成员

其他参与本次华海诚科首次公开发行股票并在科创板上市保荐工作的项目组成员还包括：申正、吴健。

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）保荐机构子公司光大富尊投资有限公司将参与本次发行战略配售，具体按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的跟投规则实施。除上述情况外，保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方权益或在其中任职等情况。

（四）本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股

东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

(五)除上述情况之外,本保荐机构与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责的其他关联关系。

五、保荐机构内部审核程序和内核意见

(一) 保荐机构内部审核程序简介

按照中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等相关法律法规及规范性文件之规定,本保荐机构推荐发行人证券发行上市前,通过履行立项、内核等内部审核程序对项目进行质量管理和风险控制,对发行人的发行申请文件、保荐工作底稿等相关文件进行了审慎核查。

保荐机构关于本次证券发行项目履行的主要内部审核程序如下:

1、2021年9月13日,本保荐机构召开投行立项小组会议,经集体投票表决,准予华海诚科IPO项目立项。

2、2022年2月25日,质量控制总部收到业务部门提交的华海诚科科创板IPO项目内核申请文件,并组织质控专员进行审核,在现场工作和审阅项目证券发行申请文件的基础上于2022年3月26日出具了《项目质量控制报告》。

3、2022年3月18日,投资银行总部组织召开问核会议,对本项目重要事项的尽职调查情况进行了问核。

4、内核办公室对本项目的内核申请材料审核无异议之后,提交内核小组会议审议。2022年3月30日,本保荐机构召开内核小组会议,对华海诚科IPO项目进行审议。

项目组落实内核小组会议意见,经内核办公室审核通过之后,项目发行申请文件履行签章审批手续,本保荐机构出具发行保荐书,正式向上海证券交易所推荐本项目。

(二) 内核意见

本保荐机构投行业务内核小组于2022年3月30日召开内核会议对华海诚科

IPO 项目进行审核，内核委员经充分讨论之后，对是否同意保荐发行人股票发行并在科创板上市进行了集体投票表决，表决结果为 9 票同意、0 票不同意。经过表决，华海诚科 IPO 项目通过本保荐机构内核，同意上报上海证券交易所。

六、保荐机构承诺事项

（一）保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行人首次公开发行股票并在科创板上市，并据此出具本上市保荐书。

（二）通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，保荐机构承诺如下：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

七、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序

（一）董事会审议通过

发行人于 2022 年 4 月 29 日召开第二届董事会第 15 次会议，全部 7 名董事均出席了会议，会议由董事长韩江龙先生主持，对本次股票发行的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项做出了决议。

（二）股东大会审议通过

发行人于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了关于本次公开发行股票并在科创板上市的有关决议，包括：本次发行股票的种类和数量、发行对象、募集资金用途、发行前滚存利润的分配方案、决议的有效期限、对董事会办理本次发行具体事宜的授权等。

经本保荐机构核查，发行人本次发行已取得了法律、法规和规范性文件所要求的发行人内部批准和授权，履行了相关决策程序。

八、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明

（一）对发行人是否符合科创板定位的说明

根据发行人出具的《关于公司符合科创板定位要求的专项说明》，本保荐机构经核查并出具了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司符合科创板定位要求的专项意见》，认为：发行人出具的专项说明和披露的科创属性信息真实、准确、完整，发行人符合科创板支持方向、科技创新行业领域和相关指标等科创属性要求。

根据《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021 年 4 月修订）》（以下简称“《暂行规定》”），发行人申请在上海证券交易所科创板上市，发行人满足下列科创属性标准：

1、公司符合科创板行业领域要求

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	公司主要从事半导体封装材料的研发及产业化。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为 C39。
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	

	<input type="checkbox"/> 节能环保	<p>根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T47542017),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子器件制造”之“电子专用材料制造”之“C3985 电子专用材料制造”。</p> <p>公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂,是半导体封装的关键材料。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所在行业归属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.3 高储能和关键电子材料制造”之“3985 电子专用材料制造”行业。</p> <p>因此,公司符合《暂行规定》第四条“申报科创板发行上市的发行人,应当属于下列行业领域的高新技术产业和战略性新兴产业:(一)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等……”的规定。</p>
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

2、公司符合科创属性要求

公司选择科创属性评价标准一进行说明,具体如下:

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$,或最近三年累计研发投入金额 ≥ 6000 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2019-2021年,公司研发投入分别为1,205.86万元、1,555.34万元和1,883.63万元,累计研发投入4,664.84万元,占累计营业收入比例为6.06%,满足最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例5%以上。
研发人员占当年员工总数的比例不低于10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至报告期末,公司共有研发人员54人,占员工总数的14.79%,满足研发人员占当年员工总数的比例不低于10%的要求。
形成主营业务收入的发明专利(含国防专利) ≥ 5 项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至本上市保荐书签署日,公司形成主营业务收入的发明专利23项,满足形成主营业务收入的发明专利5项以上的要求。
最近三年营业收入复合增长率 $\geq 20\%$,或最近一年营业收入金额 ≥ 3 亿	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2019-2021年,公司营业收入分别为17,216.98万元、24,765.40万元和34,720.03万元,复合增长率为42.01%,满足3年营业收入复合增长率达到20%的要求。

根据《科创属性评价指引(试行)》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2021年4月修订)》的规定。

(二)对发行人是否符合中国证监会规定的发行条件的说明

本保荐机构对发行人是否符合《证券法》规定的发行条件进行了尽职调查和审慎核查,核查结果如下:

- 1、具备健全且运行良好的组织机构。
- 2、具有持续经营能力。
- 3、最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告。
- 4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。
- 5、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

(三) 对发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明

保荐机构对发行人是否符合《上市规则》规定的上市条件进行了尽职调查和审慎核查，核查结果如下：

1、发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

本保荐机构对发行人是否符合《注册管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，具体如下：

(1) 发行人符合《注册管理办法》第十条规定

本保荐机构查阅了发行人的工商档案、三会资料、有关主管部门出具的证明文件、相关审计报告、纳税资料，确认发行人系由华海诚科有限按原账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。经核查，华海诚科有限成立于 2010 年 12 月 17 日，于 2015 年 12 月 16 日整体变更为股份有限公司，发行人自成立以来已持续经营 3 年以上并合法存续，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

因此，发行人符合《注册管理办法》第十条的规定。

(2) 发行人符合《注册管理办法》第十一条第一款的规定

本保荐机构查阅了发行人财务报告、发行人会计师出具的标准无保留意见的“中汇会审[2022]2038 号”《审计报告》、财务管理制度、记账凭证等相关财务资料。经核查，发行人会计基础工作规范、财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允的反映了发行人的

财务状况、经营成果和现金流量，并由会计师出具了标准无保留意见的审计报告。

因此，发行人符合《注册管理办法》第十一条第一款的规定。

(3) 发行人符合《注册管理办法》第十一条第二款的规定

本保荐机构查阅了发行人的内部控制制度文件，访谈了发行人相关人员，取得了发行人会计师出具的“中汇会鉴[2022]2039号”《内部控制鉴证报告》等相关资料。经核查，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告。

因此，发行人符合《注册管理办法》第十一条第二款的规定。

(4) 发行人符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定

本保荐机构查阅了发行人主要资产、核心技术、专利、商标等的权属文件，访谈了发行人相关人员，深入了解了发行人的组织结构、商业模式、业务流程和实际经营情况，查阅了发行人的业务合同、三会文件，实地走访了主要客户及供应商，确认发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。经核查，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

因此，发行人符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

(5) 发行人符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定

本保荐机构查阅了发行人工商档案、公司章程、三会文件、发行人会计师出具的标准无保留意见的“中汇会审[2022]2038号”《审计报告》及实际控制人签署的一致行动协议等资料，访谈了发行人高级管理人员。经核查，发行人主要从事电子封装材料的研发、生产和销售，目前主要产品包括环氧塑封料和电子胶黏剂。发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清

晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

因此，发行人符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

（6）发行人符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定

本保荐机构查阅了发行人主要资产、核心技术、专利、商标等的权属文件，确认发行人主要资产、核心技术、专利、商标等权属清晰，不存在重大权属纠纷的情况；本保荐机构取得了发行人的《企业信用报告》，检索了中国裁判文书网、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、信用中国、国家知识产权局商标局和专利局等公开信息渠道，对高级管理人员进行了访谈。经核查，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。

本保荐机构查阅分析了相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等，核查分析了发行人的经营资料、财务报告和审计报告等资料。经核查，不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

因此，发行人符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

（7）发行人符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定

本保荐机构调阅了发行人《公司章程》、营业执照、所属行业相关法律法规和国家产业政策、发行人生产经营所需的各项政府许可、权利证书或批复文件等，取得了政府有关部门的合法合规证明文件，实地查看了发行人的经营场所。经核查，发行人的生产经营活动符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

因此，发行人符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

（8）发行人符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定

本保荐机构取得了发行人《企业信用报告》，相关部门出具的无违法违规证明，发行人及其控股股东、实际控制人出具的声明和承诺等文件并进行了网络检索，经核查，最近 3 年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、

贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

因此，发行人符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

(9) 发行人符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定

本保荐机构检索了中国证监会、证券交易所等公开渠道信息，访谈了发行人董事、监事和高级管理人员，并取得了相关人员的自然人调查表及声明文件。经核查，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

因此，发行人符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

综上所述，保荐机构认为发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件。

2、发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定

本次发行前发行人股本总额为人民币 6,051.65 万元，本次发行后发行人股本总额为人民币 8,069.65 万元，发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第二款的规定。

3、发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”的有关规定

发行人本次拟公开发行不超过 2,018 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，不进行股东公开发售股份，符合《上市规则》第 2.1.1 条第三款的规定。

4、发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的标准”的有关规定

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会审[2022]2038 号”《审计报告》，发行人 2020 年、2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 2,067.61 万元、4,088.49 万元，且最近一年营业收入达到 34,720.03

万元。

本保荐机构已出具《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司预计市值的分析报告》，结合发行人最近一年内引进外部投资者的估值情况、可比上市公司在境内市场的估值等情况对发行人的预计市值进行评估，预计发行人上市后的总市值不低于人民币 10 亿元。

因此，发行人符合《上市规则》第 2.1.2 条第（一）项的上市标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”

5、发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”的有关规定

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

事 项	安 排
（一）持续督导事项	在本次发行股票上市当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
1、督促上市公司建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度。	<p>协助和督促发行人建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，并确保发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在《上海证券交易所科创板股票上市规则》下的各项义务。</p> <p>持续督促发行人健全信息披露制度，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性；督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。</p> <p>督促发行人或其控股股东、实际控制人对其承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露，并持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。发行人或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所其他规定的，及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p> <p>督促发行人积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。</p>

事 项	安 排
2、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见。	通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会、阅读发行人行业资料和媒体报道等方式，关注发行人日常经营、持续经营能力、核心竞争力和控制权稳定情况，有效识别并督促发行人履行信息披露义务，并根据监管机构的要求就有关事项对公司的影响和信息披露发表意见。
3、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定履行核查、信息披露等义务。	跟踪发行人股票交易，关注发行人股票交易情况，有效识别并督促发行人按规定履行核查、信息披露等义务。
4、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告。	通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会、阅读发行人行业资料和媒体报道等方式，关注发行人日常经营、业务和技术、控制权等方面是否出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第三章第 3.2.7 条、第 3.2.8 条和第 3.2.9 条规定的事项或其他可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项。如上述事项出现，督促公司严格履行信息披露义务，并于公司披露公告时，就信息披露是否真实、准确、完整及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第三章规定的其他内容发表意见并披露，同时就相关事项对公司的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露。 进行现场核查的，就核查情况、提请发行人及投资者关注的问题、本次现场核查结论等事项出具现场核查报告，并在现场核查结束后 15 个工作日内披露。
5、定期出具并披露持续督导跟踪报告。	在发行人年度报告、半年度报告披露之日起 15 个工作日内，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求披露持续督导跟踪报告。 持续督导工作结束后，保荐机构在上市公司年度报告披露之日起的 10 个工作日内依据中国证监会和上海证券交易所相关规定，向中国证监会和上海证券交易所报送保荐总结报告书并披露。
6、中国证监会、上海证券交易所规定或保荐协议约定的其他事项	通过与发行人建立定期沟通机制等方式，确保发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在中国证监会和上海证券交易相关规定下的义务并严格履行。
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐机构有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、上海证券交易所报告；按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐机构履行保荐工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐机构对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据。

事 项	安 排
(四) 其他安排	无

十、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他需要说明的事项。

十一、保荐机构关于本项目的推荐结论

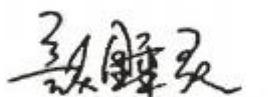
本次发行申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人进行了尽职调查、审慎核查，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐机构认为：本次首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；因此，光大证券同意作为保荐机构推荐发行人本次证券发行上市，并承担保荐机构的相应责任。

(以下无正文)

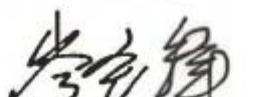
(此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人:


谈钟灵

保荐代表人:

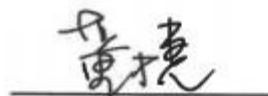

王如意


岑圣锋

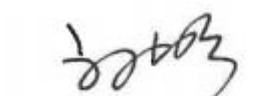
内核负责人:


薛江

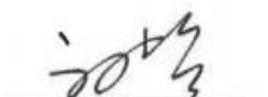
保荐业务负责人:


董捷

保荐机构法定代
表人、总裁:


刘秋明

保荐机构董事长:


刘秋明代

保荐机构: 光大证券股份有限公司(公章)



2022年6月6日